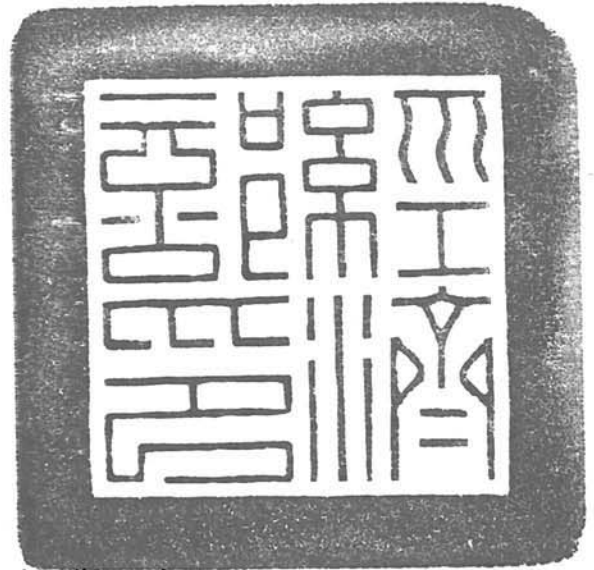


檔 號：
保存年限：

經濟部 公告

發文日期：中華民國113年12月30日
發文字號：經授產字第11351022870號
附件：公告事項



主旨：公告本部「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」公告事項，自公告之日起正式受理申請。

依據：經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法。

公告事項：「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」公告事項詳如附件。

部長 郭智輝

裝

訂

線

114 年度「驅動國內 IC 設計業者先進發展補助計畫」 公告事項

一、計畫目標

為協助國內百工百業發展，打造臺灣成為經濟日不落國，政府將協助國內系統應用業者結合半導體產業量能，因應百工百業需求，提出具創新經濟價值之解決方案，並藉由創新經濟的驅動，加速民間各行各業轉型升級，推動產業均衡發展，達到「均衡臺灣」目標，故提出「驅動國內 IC 設計業者先進發展補助計畫」(以下簡稱本計畫)。

本計畫將推動國內系統應用業者以市場需求角度，結合 IC 設計產業量能，發展具新興技術(如 AI)且有助百工百業發展之創新應用；此外也將持續鼓勵國內 IC 設計相關業者因應大健康、環境永續、新農業、傳產智慧化...等百工百業需求，開發具創新經濟價值晶片，或投入關鍵領域(軍工、安控、通訊、衛星應用...等)、高值化領域(AI、高效能運算(HPC)、車用...等)，並在該領域具備領先/優勢地位，且獲國際供應鏈信賴之晶片開發，以及擁有利基市場之晶片投產，期能結合國內 IC 產業硬實力，發展推動百工百業轉型之創新應用，同時強化臺灣在全球晶片供應之關鍵地位，避開紅色供應鏈帶來的威脅。

二、補助資格條件：

本計畫補助對象以國內系統應用業者與 IC 設計相關業者為主，可由單一企業或多家企業聯合提出申請(計畫如為 2 家以上聯合提案，須以其中一家企業擔任主導單位提出申請)。另申請企業亦應同時符合下列事項：

(一)申請企業須為國內依法登記成立之本國公司(含獨資、合夥、有限合夥事業或公司)。

1. 若本國公司為外國公司依中華民國公司法在臺登記之分公司、或本國公司為外國公司之從屬公司，非屬本計畫認定之本國公司。
 2. 若原依中華民國公司法在臺設立登記之本國公司，後因公司營運發展將部分業務轉移至國外或更改股權結構成為外國公司之從屬公司，但仍於中華民國境內進行主要營運與研發者，視為本計畫認定之本國公司。
- (二) 申請公司非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值(股東權益)應為正值。
- (三) 申請公司不得為陸資投資企業(依本部投資審議司公布之最新陸資來臺投資事業名錄認定)。

三、計畫範疇

為鼓勵國內系統應用業者結合 IC 設計產業量能，運用新興技術，發展促進百工百業轉型之創新應用，以及推動國內 IC 設計相關業者開發可帶動創新經濟(大健康、環境永續、新農業、傳產智慧化...等)，或獲得國際供應鏈信賴(軍工、安控、通訊、衛星應用、AI、HPC、車用...等)之晶片，與具利基市場之晶片投產，本計畫補助範疇包含下列 5 大類型：

(一) 高值系統與系統核心晶片開發(聯合申請)

國內系統應用業者因應百工百業需求，與國內 IC 設計業者合作，開發具新興技術之高值化應用系統，以及系統所需之核心晶片。補助上限為新臺幣 3 億元。計畫執行期程以 3 年為限。

(二) 結合既有晶片之高值系統開發(聯合申請或單一申請)

國內系統應用業者因應百工百業需求，結合國內已開發晶片，透過晶片優化、軟體加值，開發具新興技術之高值化應用系統，系統使用之核心晶片須為國內設計、製造。補助上限為新臺幣 3 千萬元。計畫執行期程以 2 年為限。

(三)創新經濟晶片開發(單一申請)

因應大健康、環境永續、新農業、傳產智慧化...等百工百業需求，開發具創新經濟價值之國產晶片。補助項目以光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)...等有助於加速晶片商品化之項目為主。補助上限為新臺幣 2 億元。計畫執行期程以 3 年為限。

(四)信賴供應鏈晶片開發(單一申請)

開發可在軍工、安控、通訊、衛星應用...等關鍵領域，或在 AI、HPC、車用...等高值化領域取得領先/優勢地位，並獲國際供應鏈信賴之晶片。補助項目以光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)...等有助於加速晶片商品化之項目為主。補助上限為新臺幣 2 億元。計畫執行期程以 3 年為限。

(五)利基型晶片投產(單一申請)

投入小批量或試量產且具利基市場之晶片投產。補助項目僅限光罩(Mask)及晶圓共乘(Shuttle)，補助上限為新臺幣 1 千萬元。計畫執行期程以 2 年為限。

四、審查重點(包含成效指標)

(一)申請公司執行計畫之研發能力與研發實績

1. 高值系統與系統核心晶片開發、結合既有晶片之高值系統開發

(1) 國內系統應用業者因應百工百業需求，與國內 IC 設計業者合作，開發具新興技術之高值化應用系統，以及系統所需之核心晶片；或結合國內已開發晶片，透過晶片優化、軟體加值，開發具新興技術之高值化應用系統(系統使用之核心晶片須為國內設計、製造)。

(2) 申請計畫應敘明欲開發系統之功能規格，擬開發(或使用、優化)之核心晶片規格、使用製程技術，以及系統驗證/場

域試煉作法，與市場化/落地應用之商業模式規劃(含產業帶動效果、產值規模推估，與協助目標行業發展之具體效益等)。

2. 創新經濟晶片開發、信賴供應鏈晶片開發

(1) 創新經濟晶片開發：因應大健康、環境永續、新農業、傳產智慧化...等百工百業需求，開發具創新經濟價值之晶片。對應之相關研發主題，應包含光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)...等。申請計畫應敘明欲開發晶片之規格、使用製程技術，以及結合應用領域相關廠商推出之具創新經濟價值的市場化/落地應用推動方案(含產業帶動效果、產值規模推估等)。

(2) 信賴供應鏈晶片開發：開發可在軍工、安控、通訊、衛星應用...等關鍵領域，或在 AI、HPC、車用...等高值化領域，取得領先/優勢地位，並獲國際供應鏈信賴之晶片。對應之相關研發主題，應包含光罩(Mask)、矽智財(IP)、下線(Tape out)、晶圓共乘(Shuttle)、電子設計自動化(EDA)...等。申請計畫應敘明欲開發晶片之規格、使用製程技術、領先/優勢地位(如國內外技術、市場競爭力之分析比較)，以及結合應用領域相關廠商推出之可獲國際供應鏈信賴的市場化/落地應用推動方案(含產業帶動效果、產值規模推估等)。

3. 利基型晶片投產：投入小批量或試量產且具利基市場之晶片投產。申請計畫應敘明欲開發晶片之規格、使用製程技術、應用產品之商業模式。

(二) 計畫時程、實施方法、技術指標、研發項目與研發經費編列之合理性等。

(三) 計畫預期產出效益(包含但不限於以下內容)

1. 高值系統與系統核心晶片開發、結合既有晶片之高值系統開發：發展促進百工百業轉型之創新應用，推動各行各業均衡發展之相關價值。
 2. 創新經濟晶片開發、信賴供應鏈晶片開發
 - (1) 投入大健康、環境永續、新農業、傳產智慧化...等應用領域之晶片開發，產品帶動之創新經濟價值與全球市場商機。
 - (2) 投入軍工、安控、通訊、衛星應用...等關鍵領域，或 AI、HPC、車用...等高值化領域之晶片開發，產品領先/優勢地位對產業競爭力之提升，與獲國際供應鏈信賴之市場商機。
 3. 利基型晶片投產：投入小批量或試量產且具利基市場之晶片投產，產品之競爭力與利基市場商機。
- (四) 委託研究及無形資產引進之內容與對象之必要性與合理性。
- (五) 公司加薪承諾：為創造「政府挺企業，企業挺員工」勞資雙贏正循環，申請公司需針對參與計畫員工提出加薪承諾及相關規劃作法，並列入計畫工作項目查核點。

五、計畫期程：

各類型計畫起始日自 114 年 4 月 1 日起，「高值系統與系統核心晶片開發、創新經濟晶片開發、信賴供應鏈晶片開發」等類型計畫之執行期程不超過 3 年；「結合既有晶片之高值系統開發、利基型晶片投產」等類型計畫之執行期程不超過 2 年。

六、應備申請資料：

- (一) 計畫申請表、公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表一式 1 份。
- (二) 計畫書一式 2 份。

(三)最近3年會計師簽證之查核報告書(若為影本須加蓋企業大小章)。

七、作業須知：

(一)企業申請本計畫以1案為限，且與本部產業技術司「IC設計攻頂補助計畫」須擇一申請。

(二)113年度已獲本部產業發展署「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」或本部產業技術司「IC設計攻頂補助計畫」補助之企業，不得再次申請；但如係擔任無形資產引進/委託研究/驗證對象則不在此限。

(三)同一企業或同一代表人於同一時期申請及執行之「產業升級創新平台輔導計畫」相關計畫總件數，不得超過3件為原則。

(四)申請公司計畫書應載明事項包括公司概況及研發能力實績、需求與應用分析及競爭分析、計畫目標與執行架構、關鍵能力分析、後續成果落實可行性規劃及市場藍圖等。

(五)申請公司應具備從事研究發展所需之人力與專案執行及管理能力並有實際績效，足以進行申請計畫之產業技術研發。

(六)案件受理後由本部產業發展署籌組專業審查小組辦理審查作業(審查小組得視需要至現場訪視)，並於核定通過後簽約執行。

(七)補助比例以計畫全程總經費50%為上限，其餘部分由申請單位自籌。

(八)補助科目依「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」公告項目。

(九)申請公司於5年內未曾有執行政府科技計畫之重大違約紀錄，及未有因執行政府科技計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。

(十)本計畫申請須知、經費編列範圍及計畫管理作業手冊等規範依產業升級創新平台輔導計畫規定辦理。

八、申請程序：

申請本計畫公司，應於公告受理期間親送或郵寄計畫書至本部產業發展署指定地點。受理日期自公告日起至 114 年 3 月 31 日止(郵寄日期以郵戳為憑；親送須於公告截止日當日下午 5 時前送達指定地址：臺北市信義路三段 41-2 號 10 樓)。公司計畫將由本部產業發展署籌組專業審查小組進行審查(專家小組得視需要至現場訪視)，並於核定通過後簽約執行。

九、其他注意事項：

- (一)本計畫優先支持符合個別領域/產業共通應用需求之產品開發，以及採用國內矽智財(IP)案件；另研發、投產之晶圓共乘(Shuttle)對象須為國內晶圓代工廠(如有特殊需求者，請敘明理由)。此外為促進我國半導體產業鏈發展，本計畫鼓勵申請企業與其上下游業者合作。
- (二)本計畫補助之矽智財(IP)費用，係指申請公司於計畫執行期間，經由技術合作、授權指導(IP 模組設計、技術服務或相關諮詢)等方式取得之無形資產所衍生之研發授權費用。公司對矽智財(IP)授權費用之編列，以占計畫總經費 20% 為上限。
- (三)本計畫採批次收件、批次審查，並依最終評核結果及推薦順序，擇優予以補助。
- (四)申請公司須派員出席審查會議並接受財務審查。另本部產業發展署得視需要召開實地查證會議，公司須派員出席。
- (五)審查通過之計畫，由申請公司與本部產業發展署委託之機構簽約。計畫執行期間，本部產業發展署委託之機構得對執行計畫之申請公司進行查證作業。

(六)政府補助款由本部產業發展署委託之機構撥付申請公司，該公司須設立專戶儲存補助款。

(七)無形資產/技術引進應註明是否為政府計畫成果，若是，則該無形資產引進應編列於自籌款；委託研究亦應標註是否為政府計畫成果，若是，須註明該政府計畫名稱並說明本申請計畫委託之技術項目與該政府計畫技術之區別。

(八)申請公司於計畫結束後，應配合本部產業發展署計畫成果展示宣導活動，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料。

(九)聯合申請案件須知

1. 聯合申請的多家企業應互推 1 家主導，並共同簽訂「合作契約書」，協調處理有關整合及各企業間權利義務與爭議等事宜。申請人各企業均應自行確保不違反公職人員利益衝突迴避法之相關規定(包括但不限於該法第 14 條第 1 項之規定)，並依其情形確實填載「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」。
2. 主導企業應具備研發管理之整合能力，有效處理多家申請單位共同執行計畫所產生之權利義務、任務分工、經費分配及計畫管理等有關事宜，否則視為未經合法申請。
3. 每家企業之補助款以不超過該企業計畫經費之 50% 為原則，各年度申請之補助款上限亦須符合會計科目與編列原則所定之原則。
4. 聯合申請的主導企業及其餘參與的執行單位皆須符合「二、補助資格條件」所列各項規定。
5. 所有參與公司須派員出席審查會議、審議會及期中末查證會議，並須接受財務審查，否則視為未經合法申請。
6. 經本部產業發展署審查通過之計畫，由主導企業與本部產業發展署所委託之機構簽約。主導企業與所有執行企業，應由

管理委員會協調，提具簽約及請領補助款所應繳交之履約保證(本票/銀行履約保證金保證書)。

7. 政府補助款由本部產業發展署所委託之機構撥付主導企業，再由主導企業撥付其他各執行企業，每家企業均須設立專戶儲存補助款並以專帳管理。
8. 計畫執行期間，本部產業發展署委託之機構得對執行計畫之全體企業進行查證作業，主導企業應負責彙整其他各執行企業之資料。
9. 多家企業聯合申請計畫之權利義務及注意事項，應符合本須知之規定。
10. 依核准計畫進行之研發行為，如涉及公平交易法所稱之聯合行為，主導企業應另依規定向公平交易委員會申請許可。
11. 全體參與企業於計畫結束後均應配合本部產業發展署計畫成果展示宣導活動及相關成效追蹤作業，並協助提供成果運用、投資金額、創造產值等計畫成效資料。

(十) 接受本計畫補助者，應落實兩性平權政策及友善家庭職場環境。

(十一) 本公告事項未盡事宜，應依「經濟部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」及其他相關法令規定辦理。